

亞洲領先的半導體製造商率先採用 QCEPT NVD 檢測解決方案 專門針對 3X 奈米記憶體與邏輯元件生產

*訂單來自全球其中兩家最大晶片製造商
完全證明支援高產量良率管理策略 NVD 檢測的重要性*

【台灣，台北，2011 年 03 月 23 日】Qcept Technologies 公司日前宣布全球其中兩家規模最大，且總部位於亞洲的半導體製造商，已採購並安裝 Qcept Technologies 公司的 [ChemetriQ](#)[®] 5000 非光學可視性缺陷(NVD)檢測系統。不論是提供有無圖案化(pattern)的晶圓，ChemetriQ 5000 都能檢測出 NVD，因此可用於廣泛的工具與在線檢測應用，以提高良率學習的速度，並讓業者能維持更高且持續的良率。

其中一家客戶已採購多部 ChemetriQ 5000 系統，用於監測 3X 奈米的記憶體與邏輯產品晶圓。第二家客戶則購買一部 ChemetriQ 5000 系統用於監測 3X 奈米記憶體晶圓。這些系統將運用於客戶生產晶圓廠中的多種應用，其中包括淨後檢測、監視反應式離子蝕刻製程(Reactive Ion Etch, RIE)、以及監視溼淨製程。

Qcept Technologies 公司執行長 Bret Bergman 表示：「我們非常高興 ChemetriQ 5000 系統在上一季獲得顧客迅速的採用。領先的半導體製造商正體認到 NVD 檢測日益成長的重要性，選擇 Qcept 協助他們強化其良率管理的策略，以確保達到最佳化的元件良率。我們期盼繼續與這些及其他客戶合作，協助解決他們各種 NVD 上的挑戰，改進其良率並提高其晶圓廠的獲利能力。」

在 3X 奈米與更小的設計節點方面，業界透過新的材料與元件結構，加上運用傳統的微影製程，可提升半導體元件的效能。業者採用這些新材料與結構時，需要極精準地控制晶圓的洗淨以及進行表面預處理(surface preparation)，因此這些製程對於元件良率的重要性也隨之升高。晶圓洗淨與表面預處理是晶圓廠中重複次數最多的步驟，每片晶圓須重複進行高達 100 次，因此有許多機會出現非最佳(sub-optimal)的洗淨製程，導致在這些先進的設計節點上會出現嚴重的良率損耗。

ChemetriQ 5000 平台能針對非最佳洗淨作業所造成的 NVD，提供快速、全晶圓、NVD 的在線檢測功能 — 如有機與無機的殘餘物、金屬污染、以及製程引發的充電—這些因素都可能導致嚴重的良率損失，但若採用光學檢測系統則無法檢測出這些缺陷來源。此平台採用一種創新的非破壞性技術來檢測晶圓表面上的功函數(work function)變化。更強化的偵測演算法加上更高的定位準確度，進一步提升 ChemetriQ 5000 的效能，不論晶圓是否已經進行微影圖案化，都能偵測出各種非光學可視性缺陷。

###

關於 Qcept Technologies Inc.

Qcept 專為先進半導體製造提供非光學可視性缺陷 (NVD) 晶圓檢測解決方案，其 ChemetriQ® 平台被廣泛應用於線上、非接觸性、全晶片檢測等關鍵製程上，例如次單層 (sub-monolayer) 有機與金屬殘留物、製程導致的電荷，以及其他無法被傳統光學測試儀器探測出的表面不均勻等非光學可視性缺陷。如欲了解更多相關資訊，請瀏覽：www.qceptech.com。

ChemetriQ 是 Qcept Technologies Inc 的註冊商標。

新聞聯絡人：

For Qcept

MCA Public Relations

David Moreno

Tel: +1-650-968-8900 ext. 125

E-Mail: dmoreno@mcapr.com

世紀奧美公關顧問

蕭雅齡 / 溫晏誼

聯絡電話：(02) 2577-2100 # 810 / 806

電子信箱：rubbyl.shiau@eraogilvy.com

freda.wan@eraogilvy.com